

巴西电子展 2024年日本东京电子元器件及制造技术展 NEPCON JAPAN

产品名称	巴西电子展 2024年日本东京电子元器件及制造技术展 NEPCON JAPAN
公司名称	星美（深圳）国际展览有限公司
价格	45800.00/件
规格参数	物流运输:展品送至贵司展位 展团服务:机票酒店餐饮大巴车一站式服务 展后补贴:一直跟进到补贴款到账
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道(龙岗段)4003号B座702-11A（注册地址）
联系电话	13682182855 13682182855

产品详情

展会介绍

日本东京电子元器件及设备展NEPCON

JAPAN是亚洲大型的电子设计、研发与制造技术展览会。日本东京电子元器件及设备展NEPCON JAPAN自1972年举办至今，随着日本电子行业的发展也在不断的成长壮大。

每年展会上都会展示众多电子制造业的**成果。涉及领域包括SMT、IC封装、PCB/PWB、测量/分析、电子元件/材料、精密加工。在2000年，日本东京电子元器件及设备展增设了IC封装技术、印制电路板以及电子元件的展览部分，进一步提高了展会的**，使之成为“电子研发、设计以及制造等领域的**性综合展览会”。日本东京电子元器件及设备展NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”较新技术的**场所而备受业界瞩目。

展会介绍：

日本国际电子元器件、材料及生产设备展览会从1972年举办至今，在2000年，日本国际电子元器件、材料及生产设备展览会增设了IC封装技术、印制电路板以及电子元件的展览部分，进一步提高了展会的价值，使之成为“电子研发、设计以及制造等领域的国际性综合展览会”，近年，在此规模基础上又新增了关于汽车电子、电动汽车、LED/OLED照明技术以及可穿戴式电子产品等拥有良好发展前景的同期展会，这一展会随着日本电子行业的发展也在不断的成长壮大自己。最近几年，来自中国、韩国、台湾的参展商以及观展人士不断增加。日本本就是电子行业的强国，如今它还在扩大自己。

市场介绍日本是一个高度发达的资本主义国家。其资源匮乏并极端依赖进口，发达的制造业是国民经济的主要支柱。科研、航天、制造业、教育水平均居shijieqian列。

此外，以动漫、游戏产业为首的文化产业和发达的旅游业也是其重要象征。据调查，日本在环境保护、资源利用等许多方面堪称世界dianfan，其国民普遍拥有良好的教育、极高的生活水平和国民素质。日本是电子工业强国，随着近年来人工智能电子工业的不断发展，日本本土的电子制造业呈现出衰退的趋势，由过去的销售快速增长到现在的依赖于电子核心部件、上游化学材料保有优势。

在返个过程中，日本市场呈现出新的需求，为中国的整机产品、配套产品制造企业打入日本市场带来了良好的契机，同时也带来了广阔的合作机遇。据日本海关统计，2019年1月，日本与中国双边货物进出口额为764.0亿美元。其中，日本对中国出口340.5亿美元，总额增长14.2%；自中国进口423.5总额增长7.0%。日本与中国的贸易逆差83亿美元。中国是日本第二大出口目的地。

日本智能制造周是亚洲lingxian规模的行业盛会，举办地涵盖亚洲商业枢纽城市和日本制造业中心的名古屋

· dingjian企业和行业lingxiu例如丰田、日产、本田、马自达、三菱、通用、现代、博世、电装、爱信、日立、谷歌、三星、夏普等来自世界各地的厂商、一级/二级代理商的工程师、业界专业人士，以及负责生产/制造/IT系统等的制造商等汇聚日本智能制造周

· 日本智能制造周包含当下热门行业
- 机器人，智能工厂，汽车制造，电子制造，全面提供智能制造解决方案

· 展会同期百场高峰论坛吸引更多海内外企业参与。

展品范围：

汽车技术

汽车半导体元件/车零部件、车载系统 车联网开发平台、工具/车联网服务；人车界面/人机界面；辅助驾驶；MaaS；电动发动机；驱动系统/线圈、磁石；EV充电设备

；磁性材料；汽车零部件加工；钣金加工；锻造/铸造；精密模型/塑胶模型；模具制造、加工；设计工程/模拟区；铝合金/镁合金/钛合金材料；来图来样加工等

机器人

工业类机器人：装配机器人、焊接机器人、传送机器人、抛光机器人、去毛刺机器人；

服务型机器人：护理机器人、接待机器人、搬运机器人、清洁机器人、安防机器人；

开发技术：智能/控制技术、传感技术、驱动技术、电子元器件/材料

电子技术

贴片机；分配器；焊接设备/材料；封装机；激光处理器；EMS制造服务；清洁/ESD保护产品；工厂设备；检查仪器；X光检验装置；测试仪；测量设备；评估检验设备；非破坏性检验设备；定制化服务；装配设备；包装材料/零件；IC包装分析/仿真软件；半导体装置检测设备；SATS/合同设计服务；电镀/蚀刻材料/设备；MEMS装置制作设备等；连接器和电缆；传感器；接线板；交换器；电阻器变压器；电路安装材料；纳米材料；刚性电路板；多层电路板；挠性电路板；多层挠性电路板；刚挠印刷电路板；拼合

电路板；半导体包装电路板；光学电路板；CAD/CAM/CIM；印刷作业；切割/钻孔技术、机密钣金加工；金属成型、锻主；精密铸造；镜片研磨；激光加工；加工/铸造技术；难加工材料等

智能工厂

IOT/M2M解决方案，云数据计算，信息安全技术，大数据，通讯设备；工业机器人，控制设备（传感器，开关），半导体；人工智能解决方案，异常检测解决方案，预测性维护解决方案，图像分析系统；制造商系统/软件；物流IT，机器人解决方案，运输技术，物流供应等

智能物流 物联网/人工智能解决方案，传感器，印刷，包装，存储，供应链关系管理，运输监控系统，数字分拣系统，无人搬运车，无人机，驾驶支持系统等

可持续制造技术

FEMS能源管理系统，可再生能源技术，节能技术，回收技术等

智能穿戴

可穿戴设备，业务改进解决方案与可穿戴设备（制造、物流服务、建筑、医疗、福利等），开发技术（电子组件/材料、AR/VR技术、传感器、新材料等）